

2020-2026年中国集成电行业市场竞争现状及前景 战略分析报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国集成电行业市场竞争现状及前景战略分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202007/886050.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2020-2026年中国集成电行业市场竞争现状及前景战略分析报告》共八章。首先介绍了集成电行业市场发展环境、集成电整体运行态势等，接着分析了集成电行业市场运行的现状，然后介绍了集成电市场竞争格局。随后，报告对集成电做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电产业有个系统的了解或者想投资集成电行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章：中国集成电行业发展分析

1.1集成电行业发展综述

1.1.1集成电行业统计标准

1.1.2集成电行业周期性

1.1.3集成电行业产业链简介

1.1.4集成电行业材料供给分析

（1）国际硅材料供应现状

（2）国内集成电生产材料供应现状

1.1.5集成电生产设备供给分析

（1）国内电子工业专用设备制造业运行情况

（2）国内集成电装备制造业状况分析

1.1.6集成电行业发展分析

（1）集成电行业政策分析

（2）集成电行业经济分析

（3）集成电行业技术分析

（4）集成电所属行业进出口分析

1.2集成电行业发展现状分析

1.2.1全球集成电行业发展现状

（1）行业需求稳健成长

（2）全球半导体资本开支开始下降，订单出货比稳定

1.2.2中国集成电行业发展现状分析

（1）行业经济指标分析

- (2) 行业结构分析
- (3) 行业总体技术水平分析
- (4) 行业总体竞争力分析
- 1.2.3 集成电行业区域发展格局分析
 - (1) 国内集成电行业区域发展现状
 - (2) 国内集成电行业整体分布格局
- 1.2.4 集成电产业面临的发展机遇
- 1.2.5 集成电行业面临的主要问题
 - (1) 对进口产品仍有较大依赖性
 - (2) 技术能力不强
 - (3) 在产业格局中处于边缘
- 1.3 集成电设计业发展分析
 - 1.3.1 集成电设计业发展概况分析
 - 1.3.2 集成电设计业市场规模分析
 - 1.3.3 集成电设计业市场特征分析
 - (1) 技术能力大幅提升
 - (2) 行业发展仍存隐忧
 - 1.3.4 集成电设计业竞争格局分析
 - 1.3.5 集成电设计业发展策略分析
 - 1.3.6 集成电设计业发展前景预测
- 1.4 集成电制造行业发展分析
 - 1.4.1 集成电制造行业发展现状分析
 - (1) 集成电制造行业发展总体概况
 - (2) 集成电制造行业发展主要特点
 - (3) 集成电制造所属行业规模及财务指标分析
 - 1.4.2 集成电制造所属行业经济指标分析
 - (1) 集成电制造所属行业经济指标分析
 - (2) 集成电制造行业主要经济效益影响因素
 - 1.4.3 集成电制造行业供需平衡分析
 - (1) 集成电制造行业供给情况分析
 - (2) 集成电制造行业需求情况分析
 - (3) 全国集成电制造所属行业产销率分析
 - 1.4.4 集成电制造行业发展前景预测
- 1.5 集成电封装测试业发展分析
 - 1.5.1 集成电封测业市场规模分析

1.5.2集成电封装业经营情况分析

1.5.3国内外厂商技术水平对比分析

1.5.4集成电封装业竞争格局分析

- (1) 国内集成电封装业竞争格局分析
- (2) 国内集成电封装企业国际竞争力分析
- (3) 集成电封装测试业竞争结构波特五力模型分析

1.5.5集成电封装业发展趋势分析

- (1) 封装技术发展趋势
- (2) 应用领域发展趋势

1.5.6集成电封装业发展前景预测

第二章：中国集成电路细分市场的需求分析

2.1IC卡市场需求分析

2.1.1IC卡市场需求现状分析

2.1.2IC卡市场需求规模分析

2.1.3IC卡发展销售预测分析

- (1) 市场占有率分析
- (2) 各企业竞争优势分析

2.1.4IC卡市场需求前景预测

2.2计算机市场需求分析

2.2.1计算机市场需求现状分析

2.2.2计算机市场供给规模分析

2.2.3计算机市场需求规模分析

2.2.4计算机市场经营效益分析

2.2.5计算机发展销售预测分析

- (1) 整体竞争格局分析
- (2) 重点企业竞争格局分析

2.2.6计算机市场发展趋势预测

- (1) PC市场结构调整，用户数量将下降
- (2) 智能化趋势提供新的机遇
- (3) 游戏本发展迅猛
- (4) 国产化替代浪潮加速

2.3无线通信设备市场需求分析

2.3.1无线通信设备市场需求现状分析

2.3.2无线通信设备市场供给规模分析

2.3.3无线通信设备市场需求规模分析

2.3.4无线通信设备发展销售预测分析

2.3.5无线通信设备市场需求前景预测

(1) 全球市场预测

(2) 国内市场预测

2.4其他消费类电子产品市场需求分析

2.4.1其他消费类电子产品需求现状分析

2.4.2其他消费类电子产品需求规模分析

2.4.3其他消费类电子产品竞争格局分析

(1) 数码相机竞争格局分析

(2) 平板电视竞争格局分析

(3) 智能穿戴设备竞争格局分析

2.5微控制单元(MCU)市场需求分析

2.5.1MCU市场需求现状分析

2.5.2MCU市场需求规模分析

2.5.3MCU发展销售预测分析

(1) MCU市场整体竞争格局

(2) MCU细分发展销售预测

2.5.4MCU市场需求前景预测

第三章：中国集成电芯片市场需求分析

3.1SIM芯片市场需求分析

3.1.1SIM芯片发展现状分析

3.1.2SIM芯片需求规模分析

3.1.3SIM芯片竞争格局分析

3.1.4SIM芯片需求前景预测

3.2移动支付芯片市场需求分析

3.2.1移动支付芯片发展现状分析

(1) 移动支付产品分析

(2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决

(3) 已有大量POS机支持NFC功能

(4) 国内供应商开始发力NFC芯片

3.2.2移动支付芯片需求规模分析

3.2.3移动支付芯片竞争格局分析

3.2.4移动支付芯片需求前景预测

3.3身份识别类芯片市场需求分析

3.3.1身份识别类芯片发展现状分析

- (1) 身份识别介绍
- (2) 身份识别分类
- 3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析
- 3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析
- 3.3.4 身份识别类芯片存在问题
 - (1) 缺乏自主知识产权
 - (2) 安全性尚待加强
 - (3) 应用尚待开发
 - (4) 解决方案仍在探索
 - (5) 上游产能不足
- 3.3.5 身份识别类芯片需求前景预测
- 3.4 金融支付类芯片市场需求分析
 - 3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析
 - 3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析
 - 3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析
 - 3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测
- 3.5 USB-KEY芯片市场需求分析
 - 3.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析
 - 3.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析
 - 3.5.3 USB-KEY芯片竞争格局分析
 - 3.5.4 USB-KEY芯片需求前景预测
- 3.6 通讯射频芯片市场需求分析
 - 3.6.1 通讯射频芯片发展现状分析
 - 3.6.2 通讯射频芯片需求规模分析
 - 3.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析
 - 3.6.4 通讯射频芯片需求前景预测
- 3.7 通讯基带芯片市场需求分析
 - 3.7.1 通讯基带发展现状分析
 - 3.7.2 通讯基带芯片需求规模分析
 - 3.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析
 - (1) 国际厂商竞争格局分析
 - (2) 国内厂商竞争格局分析
 - 3.7.4 通讯基带芯片需求前景预测
 - (1) 基带和应用处理器融合加深
 - (2) 价格战将加剧

(3) 工艺决定竞争力

3.8 家电控制芯片市场需求分析

3.8.1 家电控制芯片发展现状分析

3.8.2 家电控制芯片需求规模分析

3.8.3 家电控制芯片竞争格局分析

3.8.4 家电控制芯片需求前景预测

3.9 节能应用类芯片市场需求分析

3.9.1 节能应用类芯片发展现状分析

3.9.2 节能应用类芯片需求规模分析

3.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析

3.9.4 节能应用类芯片需求前景预测

3.10 电脑数码类芯片市场需求分析

3.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析

3.10.2 电脑数码类芯片需求规模分析

3.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析

3.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测

第四章：中国集成电下游市场需求分析

4.1 计算机行业对集成电需求分析

4.1.1 计算机行业发展现状分析

(1) 计算机行业产值规模

(2) 计算机行业外贸出口

(3) 计算机行业投资情况分析

4.1.2 计算机对集成电需求分析

4.2 智能手机行业对集成电需求分析

4.2.1 智能手机行业发展现状分析

4.2.2 智能手机对集成电需求现状

4.3 可穿戴设备行业对集成电需求分析

4.3.1 可穿戴设备行业发展现状分析

4.3.2 可穿戴设备行业对集成电需求分析

4.4 工业控制行业对集成电需求分析

4.4.1 工业控制行业发展现状分析

(1) 工业机器人发展现状

(2) 变频器发展现状

(3) 传感器发展现状

(4) 工控机发展现状

- (5) 机器视觉发展现状
- (6) 3D打印发展现状
- (7) 运动控制器发展现状
- 4.4.2 工业控制对集成电需求现状
- 4.5 汽车电子行业对集成电需求分析
 - 4.5.1 汽车电子行业发展现状分析
 - 4.5.2 汽车电子对集成电需求现状
 - 4.5.3 汽车电子对集成电需求前景
- 第五章：主要集成电行业竞争主体发展分析
 - 5.1 外商独资企业发展分析
 - 5.1.1 外商独资企业发展现状分析
 - 5.1.2 外商独资企业市场份额分析
 - 5.1.3 外商独资企业经营情况分析
 - 5.1.4 外商独资企业投资并购分析
 - 5.1.5 外商独资企业发展战略分析
 - 5.1.6 外商独资企业竞争优势分析
 - 5.1.7 对外商独资企业发展
 - 5.2 中外合资企业发展分析
 - 5.2.1 中外合资企业发展现状分析
 - 5.2.2 中外合资企业市场份额分析
 - 5.2.3 中外合资企业经营情况分析
 - 5.2.4 中外合资企业投资并购分析
 - 5.2.5 中外合资企业发展战略分析
 - 5.2.6 中外合资企业竞争优势分析
 - 5.2.7 中外合资企业存在问题分析
 - 5.2.8 中外合资企业新动向分析
 - 5.2.9 对中外合资企业发展
 - 5.3 内资企业发展分析
 - 5.3.1 内资企业发展现状分析
 - 5.3.2 内资企业市场份额分析
 - 5.3.3 内资企业经营情况分析
 - 5.3.4 内资企业扶持政策分析
 - 5.3.5 内资企业投资并购分析
 - 5.3.6 内资企业发展战略分析
 - 5.3.7 内资企业竞争优势分析

5.3.8内资企业存在问题分析

5.3.9内资企业新动向分析

5.3.10国内市场进口替代空间分析

5.3.11对内资企业发展

第六章：重点区域集成电路产业发展分析

6.1长三角地区集成电路产业发展分析

6.1.1集成电路产业发展概况

6.1.2集成电路产业政策规划分析

6.1.3集成电路设计业发展分析

6.1.4集成电路制造业发展分析

6.1.5集成电路封装测试业发展分析

6.1.6集成电路产业发展前景预测

6.2京津环渤海地区集成电路产业发展分析

6.2.1集成电路产业发展概况

6.2.2集成电路产业政策规划分析

6.2.3集成电路设计业发展分析

6.2.4集成电路制造业发展分析

6.2.5集成电路封装测试业发展分析

6.2.6集成电路产业发展前景预测

6.3泛珠三角地区集成电路产业发展分析

6.3.1集成电路产业发展概况

6.3.2集成电路产业政策规划分析

6.3.3集成电路产业配套发展分析

6.3.4集成电路设计业发展分析

6.3.5集成电路制造业发展分析

6.3.6集成电路封装测试业发展分析

6.3.7集成电路产业发展前景预测

6.4其他重点地区集成电路产业发展分析

6.4.1集成电路产业发展分析

6.4.2四川省集成电路产业发展分析

6.4.3西安市集成电路产业发展分析

6.4.4湖北省集成电路产业发展分析

第七章：集成电路企业发展分析

7.1集成电路综合型企业发展分析

7.1.1武汉光迅科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业组织架构分析
- (4) 企业产品结构分析
- (5) 企业目标市场分析
- (6) 企业营销网络分析

7.1.2大唐电信科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业组织与结构分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析

7.1.3杭州士兰微电子股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.1.4国民技术股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.1.5紫光国芯股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.1.6飞思卡尔半导体(中国)有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析

7.2 集成电设计企业发展分析

7.2.1 炬力集成电设计有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析

7.2.2 紫光股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析

7.2.3 中星微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.2.4 深圳海思半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向
- (6) 企业技术水平分析

7.2.5中颖电子股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.3集成电制造企业发展分析

7.3.1中芯国际集成电制造有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业新产品动向
- (6) 企业营销网络分析
- (7) 企业发展优劣势分析

7.3.2SK海力士半导体（中国）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业发展优劣势分析

7.3.3和舰科技（苏州）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析

7.3.4上海先进半导体制造股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析

(6) 企业发展优劣势分析

7.4集成电封装测试企业发展分析

7.4.1日月光封装测试(上海)有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业销售渠道分析

(6) 企业发展优劣势分析

7.4.2江苏长电科技股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

7.4.3苏州晶方半导体科技股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

7.4.4天水华天科技股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

7.4.5南通富士通微电子股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

第八章：集成电行业投资战略规划与

8.1集成电行业市场前景预测

8.1.1集成电行业市场规模预测（ZY ZS）

8.1.2集成电行业发展趋势分析

(1) 集成电行业区域发展趋势

(2) 集成电行业技术发展趋势

(3) 集成电行业产品结构趋势

(4) 集成电行业市场竞争趋势

8.2集成电行业投资前景分析

8.2.1集成电行业发展的影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

8.2.2集成电行业进入壁垒分析

(1) 技术壁垒

(2) 人才壁垒

(3) 资金实力壁垒

(4) 产业化壁垒

(5) 客户壁垒

8.2.3集成电行业投资风险分析

(1) 政策风险

(2) 宏观经济风险

(3) 供求风险

(4) 其他风险

8.2.4集成电行业投资前景分析

(1) 行业发展空间较大

(2) 行业政策扶持利好

(3) 下游应用市场增长迅速

(4) 行业目前投资规模偏小

8.3集成电行业投资机会与

8.3.1集成电行业投资热点分析

(1) 集成电设计业被看好

(2) 网络通信领域依然是核心

(3) 智能家居等市场集成电需求强劲

(4) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力

8.3.2 集成电行业投资机会分析

8.3.3 集成电细分市场投资

8.3.4 集成电区域布局投资

8.3.5 集成电企业并购重组

图表目录：

图表1：集成电行业代码表

图表2：摩尔定律和计算机芯片发展示意图（单位：个）

图表3：集成电产业链示意图

图表4：不同尺寸单晶硅片的生命周期示意图（单位：百万平方英寸，年）

图表5：2015-2019年国内电子工业专用设备制造业规模情况（单位：家，亿元，%）

图表6：集成电行业主要政策分析

图表7：《国家集成电产业发展推进纲要》主要内容

图表8：2015-2019年美国非农就业人口变化情况（单位：千人）

图表9：2015-2019年美国失业率情况（单位：%）

图表10：2015-2019年美国实际P年化季率（单位：%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202007/886050.html>